

3次元成形回路技術(MID)の利用による 車載部品の軽量化及び多機能化

Molded Components with Electrical Circuit directly formed on 3D surfaces

MID: Mold Interconnect Device

開発品・試作品

安全運転支援など、クルマの電子化はますます進み、車載電子部品の数が増大し、重量も増えていきます。

3次元成形回路(MID)技術は、樹脂部品の3次元表面に電気回路を直接形成することにより、

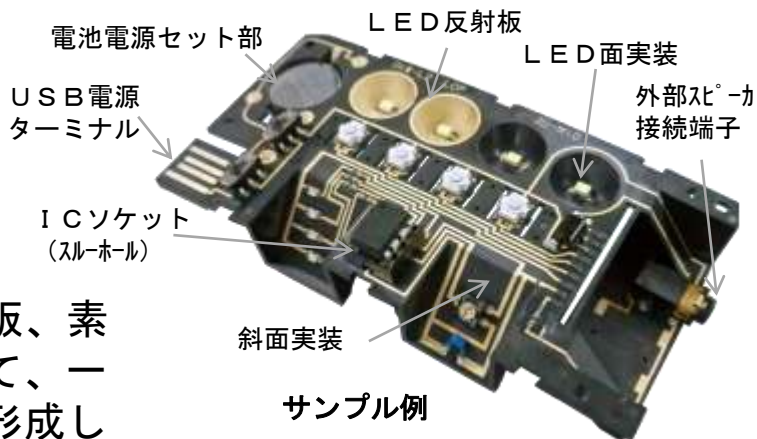
- ・機構部品と電気回路機能の一体化による部品点数の削減
- ・デバイス部品の小型、軽量化
- ・組み立て工数の削減

に大きく寄与します。

従来技術との違い

従来：複数のプリント基板、素子、構造部材を組み立てて、一つの電子回路デバイスを形成していました。

本技術：立体的な樹脂部材の3次元表面上に直接回路を形成し、素子も直接実装し、電子回路デバイスを形成します。限られた空間に合わせた形での基板製作も可能となります。更に、樹脂部材に直接配線したアンテナ化も可能です。意匠性を重視しながらも、軽量化や生産工程の削減が図れます。



(上記のサンプルは平面、曲面、斜面、側面、裏面、スルーホールに電気回路が形成され、各面に電子部品が実装された状態)



三共精密金型(株) 陸前高田工場

TEL: 0192-55-4111 FAX: 0192-54-3473

工場長 菅野信 kannom@sankyo-sk.co.jp URL: <http://www.sankyou.jp/>

営業部: 三共化成(株) TEL: 03-3752-4281 FAX: 03-3755-1689